

证券代码：300666

证券简称：江丰电子



**宁波江丰电子材料股份有限公司  
向特定对象发行股票  
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）**

**2025 年 9 月**

## 一、本次募集资金的使用计划

在考虑从募集资金总额中扣除 2,000 万元的财务性投资后，本次发行的募集资金总额不超过 194,782.90 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

| 序号 | 项目名称                               | 总投资金额<br>(万元) | 拟使用募集资金<br>(万元) |
|----|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 年产 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化项目         | 109,790.00    | 99,790.00       |
| 2  | 年产 12,300 个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目 | 35,000.00     | 27,000.00       |
| 3  | 上海江丰电子研发及技术服务中心项目                  | 9,992.90      | 9,992.90        |
| 4  | 补充流动资金及偿还借款                        | 58,000.00     | 58,000.00       |
| 合计 |                                    | 212,782.90    | 194,782.90      |

在董事会审议通过本次发行方案后、募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，公司将通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。

## 二、本次募集资金使用的具体情况

### （一）年产 5,100 个集成电路设备用静电吸盘产业化项目

#### 1、项目的基本情况

本项目旨在充分发挥公司半导体超高纯金属溅射靶材及精密零部件领域所积累的产研技术及客户优势，实现静电吸盘产品的量产和销售，以缓解我国高端静电吸盘供求失衡的局面，助力我国半导体产业链的自主可控性。

本项目总投资额为 109,790.00 万元，拟使用募集资金 99,790.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 具体项目  | 总投资金额     | 拟使用募集资金   |
|----|-------|-----------|-----------|
| 一  | 建设投资  | 99,790.00 | 99,790.00 |
| 1  | 建筑工程费 | 9,050.00  | 9,050.00  |

| 序号    | 具体项目   | 总投资金额      | 拟使用募集资金   |
|-------|--------|------------|-----------|
| 2     | 设备投资   | 90,740.00  | 90,740.00 |
| 二     | 铺底流动资金 | 10,000.00  | -         |
| 项目总投资 |        | 109,790.00 | 99,790.00 |

本项目由公司全资子公司宁波晶磐电子材料有限公司（原名：宁波江丰同创电子材料有限公司）和北京江丰电子材料有限公司共同实施，实施地点分别为浙江省余姚市和北京市，项目预计建设周期为 24 个月。

## 2、项目用地及相关审批备案事项

本项目实施不涉及新增土地。截至本预案公告日，本项目已取得《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2506-330281-04-01-821536）和《北京经济技术开发区企业投资项目备案证明》（京技审项（备）〔2025〕138 号）、《北京经济技术开发区企业投资项目备案变更证明》（京技审项函字[2025]59 号），环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行程序。

### （二）年产 12,300 个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目

#### 1、项目的基本情况

本项目将建设公司在韩国的生产基地，加速公司全球化战略布局，实现对 SK 海力士、三星等重要客户覆盖，提升公司属地化服务能力，为公司的国际化发展战略奠定基础。

本项目总投资额为 35,000.00 万元，拟使用募集资金 27,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号    | 具体项目   | 总投资金额     | 拟使用募集资金   |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 一     | 建设投资   | 30,000.00 | 27,000.00 |
| 1     | 建筑工程费  | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 2     | 设备投资   | 11,900.00 | 8,900.00  |
| 二     | 铺底流动资金 | 5,000.00  | -         |
| 项目总投资 |        | 35,000.00 | 27,000.00 |

本项目由公司全资孙公司捷丰先进材料科技有限公司（KFAM CO., LTD.）

实施，实施地点为韩国庆尚北道龟尾市，项目预计建设周期为 24 个月。

**2、项目用地及相关审批备案事项**

截至本预案公告日，本项目已取得宁波市发展和改革委员会审批的《项目备案通知书》（甬发改开放〔2023〕415 号）及宁波市商务局审批的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3302202300242 号）。

**（三）上海江丰电子研发及技术服务中心项目**

**1、项目的基本情况**

本项目将建设上海研发及技术服务中心，旨在进一步提升公司的技术实力和产品国际竞争力，同时打造区域性更强的综合性服务中心。

本项目总投资额为 9,992.90 万元，拟使用募集资金 9,992.90 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 具体项目   | 总投资金额    | 拟使用募集资金  |
|----|--------|----------|----------|
| 一  | 建设工程   | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 二  | 硬件设备购置 | 6,942.90 | 6,942.90 |
| 三  | 软件购置   | 500.00   | 500.00   |
| 合计 |        | 9,992.90 | 9,992.90 |

本项目的实施主体为公司全资子公司上海江丰电子材料有限公司，实施地点为上海市临港新片区，项目预计建设周期为 24 个月。

**2、项目用地及相关审批备案事项**

本项目实施不涉及新增土地。截至本预案公告日，本项目已取得《上海市企业投资项目备案证明》（上海代码：310115MA7BBUBF420251D2203001，国家代码：2504-310115-04-01-205871），本项目无需办理环评事项。

**（四）补充流动资金及偿还借款**

公司拟使用本次募集资金中的 58,000.00 万元补充流动资金及偿还借款，以满足公司日常经营资金需要、优化资产结构，增强公司的抗风险能力。

### 三、本次募集资金使用的必要性与可行性分析

#### （一）项目实施的必要性

##### 1、把握全球集成电路产业快速发展和半导体靶材、精密零部件自主可控的历史机遇

随着人工智能、5G 通信、物联网、云计算、汽车电子、机器人和无人机等应用领域市场的持续成长，全球集成电路产业市场景气度高涨。根据 WSTS 数据，2023-2024 年，全球半导体行业规模分别约 5,269 亿美元、6,269 亿美元，2025 年预计达到 6,972 亿美元。其中，中国集成电路产业受益于巨大的市场需求、稳定的经济增长及有利的产业政策引导等因素，市场规模增速全球领先。根据国家统计局数据，中国集成电路产量由 2015 年的 1,087.10 亿块增长至 2024 年的 4,514.23 亿块，年均复合增长率超 17%。

集成电路产业的高景气度带动了半导体材料、半导体设备及零部件的需求快速增长。但在半导体超高纯金属溅射靶材、关键设备及精密零部件等重要领域，全球仍呈现寡头竞争格局，由美国、日本等少数几家企业占据绝大部分市场份额。

在超高纯金属溅射靶材领域，公司打破了我国半导体领域靶材长期依赖进口的局面，实现了对行业内国际领先企业从“追赶”到“并跑”的跨越式发展，但超高纯金属溅射靶材国产化率较“十三五”规划提出的目标仍有一定距离，公司需持续加大研发创新投入及产能建设，推动该领域国产化率的进一步提升；在持续推动国内该领域产品自主可控的同时，公司致力成为一家能够“走出去”且具备国际竞争力的全球化企业，进一步提升市场份额和品牌影响力。

在半导体精密零部件领域，近年来，公司持续加大自主创新和研发力度，将在靶材领域长期积累的技术研发、品质保障、客户服务等能力成功应用到该领域，推动产品线迅速拓展及量产，目前已实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用。公司计划进一步加大投入，持续完善半导体精密零部件业务布局，补齐短板，为国家半导体零部件产业自主可控提供重要支撑。

因此，在全球集成电路产业快速发展及国内对于半导体关键材料、设备、零部件自主可控迫切需求下，公司拟通过实施本次募投项目，一方面优化产能布局、

践行公司国际化发展战略；另一方面充分发挥公司在既有超高纯金属溅射靶材、精密零部件领域的技术及制备优势，进一步填补国内半导体关键零部件短板。

## **2、建设先进制程靶材全球化生产基地，优化产能布局，提升国际竞争力**

就市场需求而言，一方面，随着全球晶圆产能产量不断增加及晶圆芯片制造朝着先进制程方向发展，超高纯金属溅射靶材需求持续提升，市场空间广阔。我国超高纯金属溅射靶材市场亦在下游需求增长及国产化率提升的双重驱动下，呈现良好的市场发展前景；另一方面，国际上知名半导体客户通常对上游供应商的产品先进性、产能规模及布局、工厂智能制造水平、属地化服务等综合能力有较高的评价准入要求。

近年来，公司超高纯靶材业务呈现业务发展快、收入增速高、产能利用率趋于饱和的状态。在全球超高纯溅射靶材需求持续增加及国产化率有待进一步提升背景下，公司已建及在建产能预计无法满足未来的市场需求，公司需进一步突破产能瓶颈。同时，公司目前的生产能力集中于中国大陆，建设全球化生产基地，有利于公司进一步提升对国际知名客户的服务半径和供应份额，缩小与全球头部企业差距，并在复杂严峻的国际环境形势下增强自身的抗风险能力，对公司加速全球化战略布局、提升国际竞争力具有重要意义。

在前述背景下，公司拟通过在韩国建设先进制程靶材生产基地，一方面有助于公司优化产能布局及突破产能规模，境内产能用以满足国内半导体行业持续增长的靶材需求、进一步推动国内超高纯溅射靶材的国产化程度，境外产能将重点覆盖 SK 海力士、三星等国外客户，提升公司属地化服务能力及国际竞争力，缩小与全球头部企业的差距；另一方面，该项目的实施有助于推进公司和全球上下游产业链企业的深入合作，帮助公司进一步洞悉行业发展趋势、拓展潜在订单和客户，为公司的国际化发展战略奠定基础。

## **3、突破静电吸盘技术瓶颈，填补国内半导体关键零部件短板**

静电吸盘是一种适用于真空环境或等离子体环境的超洁净晶圆片承载体，其利用静电吸附原理进行超薄晶圆片的平整均匀夹持，此外还发挥散热作用，运用导热系统和通氦气的方式导出加工过程中产生的热量，确保晶圆加工精度和稳定

性。相较于传统机械卡盘、真空卡盘，静电吸盘在吸附力、晶圆保护、工作环境等方面具有较大优势，广泛应用于光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备等关键工艺环节。静电吸盘的性能及品质会直接影响芯片制造的良率和效率。

静电吸盘使用寿命通常不超过 2 年，属于消耗类零部件，市场需求大。当前，全球静电吸盘市场基本由美国、日本等少数企业占据。我国该领域内主要企业目前可实现小尺寸晶圆制造用静电吸盘的小批量生产销售，先进制程用静电吸盘量产能力不足、仍主要处于研发或客户评价的阶段，静电吸盘整体国产化率不足 10%。同时，近年来，受国际贸易及技术管控等政策影响，海外企业对我国半导体设备及零部件的出口管控不断升级，作为半导体关键设备及晶圆制造环节的重要部件，静电吸盘国产化率水平亟需进一步提升。

在前述背景下，公司拟通过国内静电吸盘产业化项目的建设实施，致力突破生产静电吸盘关键材料技术瓶颈，从源头上解决静电吸盘核心材料和设备“卡脖子”难题，最终推动缓解我国高端静电吸盘供求失衡的局面，填补国内半导体关键零部件短板。

#### **4、充分利用上海及长三角半导体产业区位优势，提升公司创新服务能力**

集成电路是上海三大先导产业之一，作为国际科技创新中心，上海汇聚了国内半导体行业大量产业优质人才和创新资源，且在上海引领带动下，以上海为中心的长三角地区的协同发展进一步深化，目前，长三角已经发展形成国内产业链布局最完备、产业技术优势最突出的半导体产业集群之一，具有突出的政策优势、技术优势和人才优势。

2024 年 3 月，上海市国资委在 2024 上海全球投资促进大会上宣布，聚焦产业基金，围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，推动设立总规模 1000 亿元的产业投资母基金，以发挥“投早投小”、产业投资、并购整合、补链强链功能；2025 年上海市政府报告提出，2024 年，上海市集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到 1.8 万亿元，2025 年，将着眼产业高端化，深入实施三大先导产业新一轮“上海方案”，优化集成电路产业空间布局。

公司拟通过实施上海江丰电子研发及技术服务中心建设项目，充分利用上海

及长三角地区产业集群资源、政策重点扶持、行业高端人才集聚等区位优势。一方面，通过配备具备国际先进水平的研发环境及设备、吸引优质技术人才等，公司将进一步建设升级研发检测中心，推动产品技术的创新发展，夯实公司核心技术护城河；另一方面，公司将建设区域性更强的综合性服务中心，统筹管理销售工作，更加及时有效地推广公司各类产品和技术服务，全方位地为客户呈现公司产品信息、技术交流与支持、解决方案与售后跟进等服务，更快速地洞见行业发展趋势与需求，保持公司行业领先的竞争地位。

## **5、增强公司资金实力，优化财务结构，提升公司抗风险能力**

自上市以来，公司经营规模保持快速增长，营业收入由 2017 年度的 55,002.57 万元提升至 2024 年度的 360,496.28 万元，年均复合增长率超过 30%。2024 年度，公司两大核心业务板块超高纯靶材及精密零部件业务收入同比增长分别为 39.51%和 55.53%，公司收入端呈现快速且持续的增长趋势。随着公司半导体用超高纯溅射靶材、半导体精密零部件产量及业务规模进一步扩大，公司对营运资金存在较大需求。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 51.03%，长短期借款余额为 323,629.75 万元。通过补充流动资金及偿还银行借款，一方面有利于公司扩大经营规模、持续加大在产品与技术端的创新投入，充分把握市场机遇，加速超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件的国产化进程；另一方面，能够有效缓解公司营运资金需求，降低公司资产负债率，减少财务费用支出，优化资本结构，提高抗风险能力，有利于公司持续、稳定、健康、长远发展。

## **（二）项目实施的可行性**

### **1、本次项目实施具备良好的政策环境及产业生态**

集成电路是互联网、大数据、云计算、人工智能、交通运输、通讯等产业的基础，是关系国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业。近年来，我国不仅在战略层面高度重视集成电路行业的持续发展及自主可控，亦出台了一系列有效措施以支持集成电路行业发展，构建了良好的政策环境及产业生态。

2023 年 4 月，财政部、税务总局发布了《关于集成电路企业增值税加计抵



减政策的通知》，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额，降低了集成电路企业的经营成本，为集成电路企业的高质量发展提供了机会；2023 年 8 月，工信部发布了《电子信息制造业 2023—2024 年稳增长行动方案》，明确“集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域”是提升产业链现代化水平的重点领域，对“充分调动各类基金和社会资本积极性，进一步拓展有效投资空间，有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设”表达了支持的态度；2024 年 6 月，国家发布《关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》，鼓励首台（套）重大技术装备、首批次新材料创新发展，有助于半导体行业的关键设备和材料实现国产化替代；2024 年 12 月，财政部发布《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，提出在政府采购活动中给予本国产品 20%的价格评审优惠。该政策将推动提高国产芯片、半导体设备等产品的性价比及政府采购份额，加速国产替代进程。

在地方层面，上海市政府 2023 年发布《关于新时期强化投资促进加快建设现代化产业体系的政策措施》，提出拓展集成电路等先导产业新空间，围绕芯片设计、制造、封测、装备、材料等领域，积极招引硬实力优质企业落地；上海国资委在 2024 年宣布推动设立 1,000 亿元规模的产业投资母基金，引导集成电路等三大先导产业快速发展。而作为浙江省乃至全国集成电路重要的制造基地，宁波形成了涵盖材料企业、设计企业、制造企业、封装测试企业、设备及服务企业、应用企业的集成电路完整产业链，并与杭州、上海等地之间形成了产业共建体系。宁波经信局发布的《宁波市电子信息制造业产业集群发展规划（2019-2025）》中提到，将集成电路、光学电子等列入重点领域，将江丰电子及超高纯金属溅射靶材列入重点培育企业与主要产品。

在韩国当地，2021 年 5 月，韩国科学技术信息通信部发布《K—半导体战略》。据此，韩国政府将携手相关企业，至 2030 年在韩国构建起全球性大规模半导体产业供应链，建立起集半导体生产、材料、零部件、设备和尖端设备、设计等为一体的高效产业集群，政府为企业提供的租税减免、扩大金融服务和基础设施等多项支持。

综上，公司实施本次募投项目具备良好的政策环境及产业生态。

## **2、本次项目实施具有广阔的市场空间**

随着人工智能、5G 通信、物联网、机器人等前沿技术的迅速普及和广泛应用，芯片需求持续大幅增长，同步带动了超高纯金属溅射靶材市场规模持续稳定增长。根据弗若斯特沙利文报告，预计至 2027 年，全球半导体溅射靶材市场规模将达 251.10 亿元，市场空间广阔，我国半导体集成电路用溅射靶材市场保持稳定增长态势，2018-2024 年，我国半导体溅射靶材市场规模从 15.80 亿元增长至 37.40 亿元，年均复合增长率为 15.44%，预计 2027 年该市场规模将达到 57.40 亿元。

静电吸盘系半导体关键设备的重要部件，由于使用寿命较短，在晶圆制造环节中存在较大更新替换的需求。根据 SEMI 统计数据，2023-2024 年，全球半导体设备支出分别为 1,063 亿美元和 1,171 亿美元，设备支出预计持续增长，在 2026 年达到 1,390 亿美元，随着全球半导体设备支出及晶圆产能产量持续扩张，静电吸盘市场规模将会同步提升，根据 QY Research 研究统计，2030 年全球晶圆静电吸盘市场规模预计将达到 24.24 亿美元。

近年来，在下游需求快速增长及产业链自主可控背景下，中国大陆稳居全球半导体设备支出最大市场，并已具备全球第二大的晶圆代工产能。根据 SEMI 统计数据，2022-2024 年，中国大陆半导体设备支出自 282.70 亿美元增长至 495.50 亿美元，且 2025-2026 年仍将保持 380 亿美元、360 亿美元的大规模支出水平；同时，2024 年中国大陆芯片制造商产能增长 15%，每月达 885 万片晶圆，预计 2025 年将继续保持 14% 的增幅，月度产能达 1,010 万片晶圆，并有望在 2030 年成为全球最大的晶圆代工产能地。在该背景下，我国静电吸盘领域同样存在广阔的市场空间及迫切的国产化需求。

综上，公司实施本次募投项目具有广阔的市场空间。

## **3、本次项目实施具有丰富的研发能力、人员、技术储备及制备经验**

在研发能力方面，公司拥有“国家企业技术中心”、“国家示范院士专家工作站”、“省级高新技术企业研发中心”、“国家博士后科研工作站”以及“浙江省重

点企业研究院”等研发创新平台，具备较好的研发基础。自成立以来，公司先后承担了国家 863 计划引导项目、国家 02 科技重大专项、电子发展基金项目等累计 20 余项国家级科研及产业化项目。公司持续推进我国半导体多个细分领域的自主可控进程，连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体材料十强企业”；2021 年，公司“超高纯铝钛铜钽金属溅射靶材制备技术及应用”项目荣获 2020 年度国家技术发明二等奖；2022 年，公司获评“制造业单项冠军示范企业（2023-2025 年）”；2025 年，公司溅射靶材在中央广播电视总台主办的“以科技创新引领新质生产力发展——2024 新质生产力年度盛典”中，成功入选“2024 新质生产力年度十佳案例”。

在研发及技术人员方面，公司现有研发及技术人员近四百名，核心团队由多位具有金属材料、集成电路及平板显示制造专业背景和丰富产业经验的归国博士、日籍专家及资深业内人士组成。公司首席技术官姚力军先生一直从事超高纯金属材料及溅射靶材的研究，公司技术团队的主要成员亦具有十余年的半导体行业从业经历。此外，公司还自主培养了一大批本行业的专业骨干、技术专家和业务专家，为产品的持续创新和技术领先提供了坚实的保障。

在技术储备及制备经验方面：（1）在超高纯金属溅射靶材领域，经过数年的科技攻关和产业化应用，公司已发展成为行业领先企业，实现了对半导体用超高纯钽（Ta）、铜（Cu）、钛（Ti）、铝（Al）靶材的晶粒晶向精细调控技术、大面积无缺陷焊接技术、精密机械加工技术及高洁净清洗封装技术等关键技术的攻克，全面覆盖了先进制程、成熟制程和特色工艺领域。尤其在先进制程领域，公司能够持续适应下游客户不同的技术路线演变需求和变革需求，从而实现先进制程领域超高纯金属溅射靶材在客户端的规模化量产，在全球范围内积极参与和美国、日本等跨国公司的市场竞争，不断进入国内外优质客户的供应链体系；（2）在静电吸盘领域，公司在超高纯溅射靶材领域具备的材料研发能力及在半导体精密零部件领域积累的精密制造、表面处理及温度控制等技术储备，均能为公司攻克静电吸盘生产所需的关键材料技术瓶颈提供有效支持。

综上，公司实施本次募投项目具有丰富的研发能力、人员、技术储备及制备经验。

#### **4、本次项目实施具备良好的客户资源**

半导体行业内有较为严格的认证体系和供应商资质认证体系，若要进入国内外芯片制造及设备厂商的供应链，需要经过长期且严苛的客户认证，获得认证后也要持续进行不定期的资质复审，方能与下游客户建立长期稳定的合作关系。

在半导体超高纯金属溅射靶材领域，公司已成为中芯国际、台积电、SK 海力士等国内外知名厂商的重要供应商，半导体超高纯金属溅射靶材业务已发展为公司最主要的收入来源，业务增速快，且公司在韩国当地及周边区域已拓展积累了优质的客户资源。未来，公司在韩国当地建设靶材生产基地具备凭借良好的客户资源和市场需求消化新增产能的优势。

在半导体精密零部件领域，公司已成为国内多家知名半导体设备公司和国际一流芯片制造企业的核心零部件供应商，合作及订单具备较强的持续性。2022-2024 年，公司精密零部件业务收入自 35,959.43 万元增长至 88,670.23 万元，年均复合增长率超过 50%，业已发展为公司第二成长曲线。正如公司利用在半导体超高纯金属溅射靶材领域的资源优势拓展精密零部件业务，公司目前在半导体精密零部件领域积累的客户禀赋亦与静电吸盘的市场需求高度重合，公司对现有零部件业务的持续深耕预计能够为未来静电吸盘量产后的市场拓展、产能消化奠定良好基础。

综上，公司实施本次募投项目具有良好的客户资源。

#### **5、公司法人治理结构完善，内控体系健全**

公司将本次发行募集资金部分用于补充流动资金及偿还借款，符合公司所处行业发展现状及公司业务发展需求，可以满足公司日常经营的资金需求，有利于增强公司的资本实力和抗风险能力。公司本次发行募集资金部分用于补充流动资金及偿还借款，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，方案切实可行。

公司已形成较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司已制定《募集资金管理制度》，在募集资金的存储、使用等方面作出明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金

的存储和使用，确保本次发行募集资金的存储、使用和管理符合相关规定。

## **四、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响**

### **（一）本次发行对公司经营管理的影响**

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目均紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产业政策，具有良好的市场前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施，将促进公司半导体用超高纯金属溅射靶材及精密零部件业务进一步发展，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，同时提升公司的抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

本次发行完成后，公司的主营业务范围不会发生重大变化。公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持自身各方面的完整性，保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在人员、机构、财产、财务、业务等方面的独立性。本次发行对公司的董事及高级管理人员均不存在实质性影响。

### **（二）本次发行对公司财务状况的影响**

本次发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资产负债率将有所下降，财务费用将有所减少，资本结构得以优化，从而有效降低公司的财务风险，改善公司财务状况，进一步提升公司的资本实力和抗风险能力，对公司未来发展具有长远的战略意义。

## **五、本次募集资金投资项目可行性分析结论**

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。本次向特定对象发行股票募投项目具有良好的市场前景和经济效益，有利于推进公司的发展战略，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司的市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。

（本页无正文，为《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》之签章页）

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日